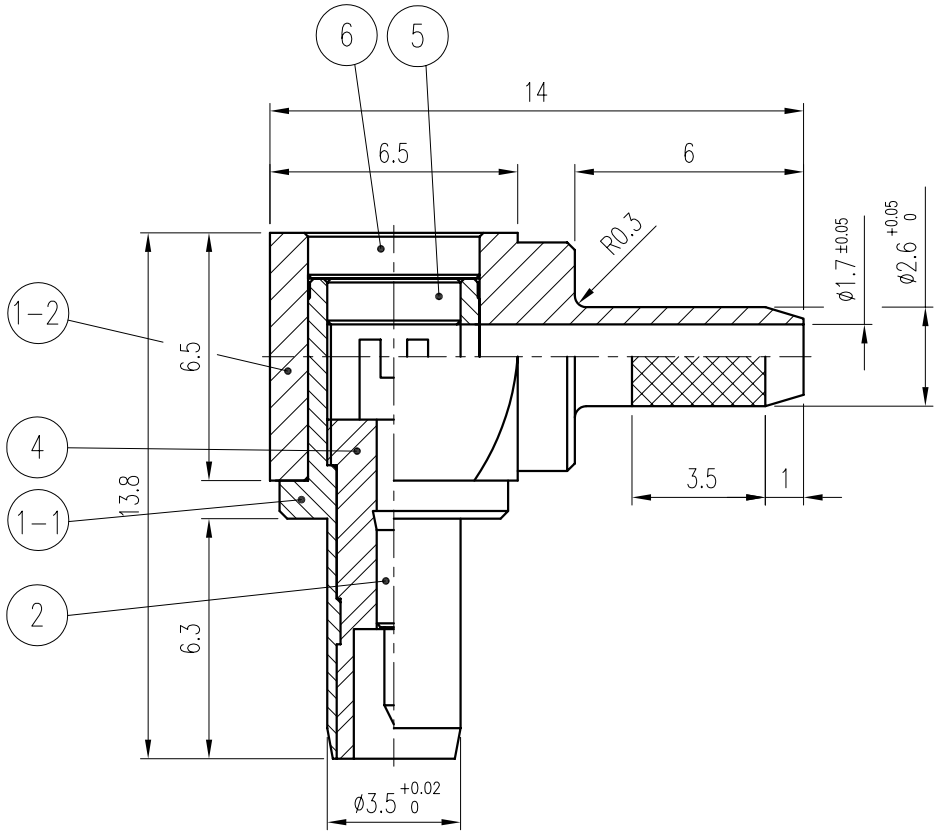
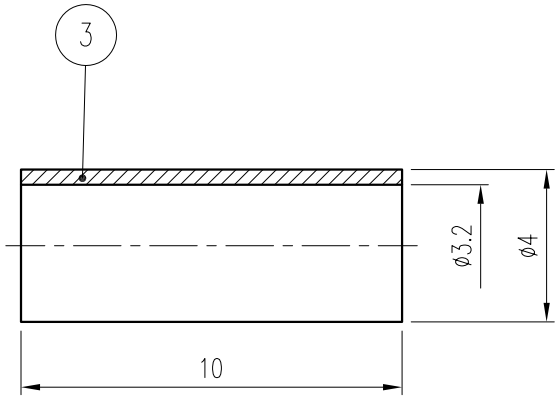
가공 / ST									
ST(기존)									
ST(개선)									

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





품번		품 명	수량	재 질	표면처리	비 고	
6		COVER	1	MBsBD	Nickel Plate (5μm이상)	DCO00020-5/1 (L3023)	
5		INSULATOR	1	TEFLON		DIN00922-N/1 (H3143)	
4		INSULATOR	1	TEFLON		DIN00298-N/2 (H3137)	
3		FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00034-5/1 (F3010)	
2		CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate (0.4μm이상)	DCT00393-5/1 (E3154)	
1	1-2	BODY(B)	1	MBsBD	Nickel Plate (5μm이상)	DBB00181-5/1	DBD00455-3/1 (D3157B)
	1-1	BODY(A)	1	MBsBD	Nickel Plate (5μm이상)		DBD02178-3/1

주 기

1. 상대물과 삽입력과 이탈력
   - 삽입력 : 2~4kgf 이하
   - 이탈력 : 5~8kgf 이상
2. 상대물 MALE외경 ϕ3.65~3.67이며 MAX쪽으로 관리하도록 되어있음.
3. 도금 사양

   내장용(실내)
   - Nickel Plate : 5μm 이상 (BODY,JACK,COVER)
   - Gold Plate : 0.4μm 이상 (CONTACT)

   외장용 및 수분,유해가스 접촉부
   - Gold Plate : 0.4μm 이상 (BODY,CONTACT,JACK,COVER)

대체가능재질	년월일	2008. 10. 02.	KJ COMTECH KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	승인		
재질	검도		도명 SMB-LJC-316
열처리	제도		
보호피막처리	작성부서	연 구 소	A4 도번 CN02188-7/1
	척도 1.5/1	단위 mm	중량